

2025 年 8 月 21 日

各 位

薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®」の生産体制追加増強

～ マレーシア工場・上尾事業所の 2 拠点で生産能力を約 1.6 倍へ ～

当社（社長 納 武士）は、マレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia)SDN.BHD.）および上尾事業所にて製造している薄型基板内蔵キャパシタ材料「FaradFlex®」の生産体制について、2022 年 7 月 28 日ニュースリリース「薄型基板内蔵キャパシタ材料の生産能力増強および BCP 体制構築」にて公表しました通り、生産能力増強および BCP 体制構築を完了いたしました。さらに 2026 年 3 月までに、現在の約 1.6 倍まで生産能力を増強することをお知らせいたします。

当社の FaradFlex®は、各種情報通信機器の高速化・大容量化に向けて大きな課題である通信ノイズを低減する材料として、高性能のルーター・サーバー機器やスーパーコンピュータ向けの高多層基板、スマートフォンに内蔵される MEMS マイクロフォンなどに使用されており、極薄銅箔 MicroThin™ や高周波基板用電解銅箔 VSP™に続く成長事業と位置付けております。足元は AI インフラ関連、スマートフォンおよびワイヤレスヘッドセットなどへの当社品採用率の上昇に伴って需要が急増しております。今後も市場の成長が見込めることから、FaradFlex®の生産拠点であるマレーシア工場および上尾事業所の両拠点で生産能力を増強することといたしました。

現在、マレーシア工場と上尾事業所の 2 拠点体制における合算生産能力は、2022 年から約 2.2 倍に増強が完了しておりますが、引き続き生産設備の増設や現有設備でのさらなる生産性改善を進める事で、2026 年 3 月までに約 1.6 倍(2022 年比較で約 3.5 倍)の生産体制へ増強いたします。

これらの施策により生産能力は増加いたしますが、今後もさらなる需要拡大に応じた増強も視野に入れ、旺盛な需要に十分対応してまいります。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030 年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で “未来” に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献してまいります。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

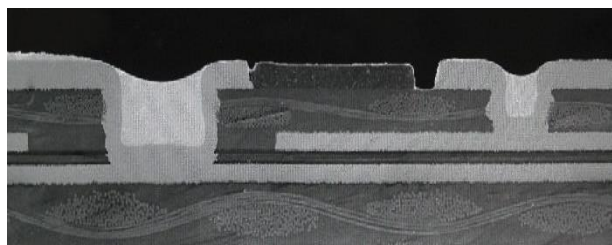
TEL : 03-5437-8028 E-mail : PR@mitsui-kinzoku.com

(ご参考)

1. FaradFlex®の構造

FaradFlex®は、3～25 μm の極薄絶縁層を銅箔（厚さ 18～70 μm ）でサンドイッチ状にした構造の材料。基板に内蔵された FaradFlex®で、キャパシタとなる回路を形成する。

FaradFlex®を含むプリント配線板断面図



} FaradFlex®（銅箔／絶縁層／銅箔の3層構造）

2. 基板内蔵キャパシタの使用イメージ

FaradFlex®を使用することで、IC の直下にキャパシタ層を形成することができる。IC とキャパシタ層の距離を縮めることで、通信ノイズを低減することができる。

